



（駒ヶ根工場の全景）

- 本社所在地：東京都港区三田2-2-18
- 事業概要：航空機部品、半導体製造装置用部品及び宇宙ロケット部品の製造
- 常時使用する従業員：178名（2025年5月時点）
- 現在の売上高：41億円（2024年8月期）
- 法人番号：5010401027009
- Web：
<http://www.heiwasangyo.co.jp/>

企業理念・100億宣言に向けた経営者メッセージ



代表取締役社長
八尾泰弘

安全保障に資する製造業エンジニアが活躍する未来創り

平和産業は研究開発を行う大企業下請けとして半世紀以上の経験を積み上げ、切削加工領域における挑戦者であった。世界的に優秀な工作機械メーカーと日本を代表する航空宇宙防衛、半導体製造装置製造メーカーの切削加工技術を研鑽し続けながら、DX思想の到来で大企業に負けない労働生産性を作り出す機会を得た。今こそ、多様な顧客から要請される当社技術の集大成をもって急激な増産要請がある防衛装備品開発量産、コロナ禍でサプライチェーンの崩壊した航空機機体部品の再量産、エンジン部品の増産、半導体部品の開発支援能力を集中的に向上させ、従業員待遇を元受け大企業に倣える待遇とし、国際製造競争に負けない国内リソース維持に資する会社づくりを目指します。

売上高100億円実現の目標と課題

実現目標

2030年の飛翔体製品量産時点にむけて、大企業設計による完成部品製造売上を3倍増できる管理体制と製造能力を構築。下請け事業としての航空機部品（エンジン、機体）再増産を支える製造、品質管理の向上、半導体他の開発案件を継続的に寄り添える下請け事業を連立させ最低売上100億円が維持継続できる会社創りを目標とする。

課題

- ・国内6工場に分かれる生産拠点をいかにデジタル技術でつなぎ一体化した製造運営ができるか。
- ・30億円を目標としていた、会社組織で100億円を扱うことによるインフラストラクチャーの充実や人的資源の不足、管理手法の未成熟を投資と合理化で対応しなければならない。
- ・完成部品受注が継続できる信頼される会社づくり。

売上高100億円実現に向けた具体的措置

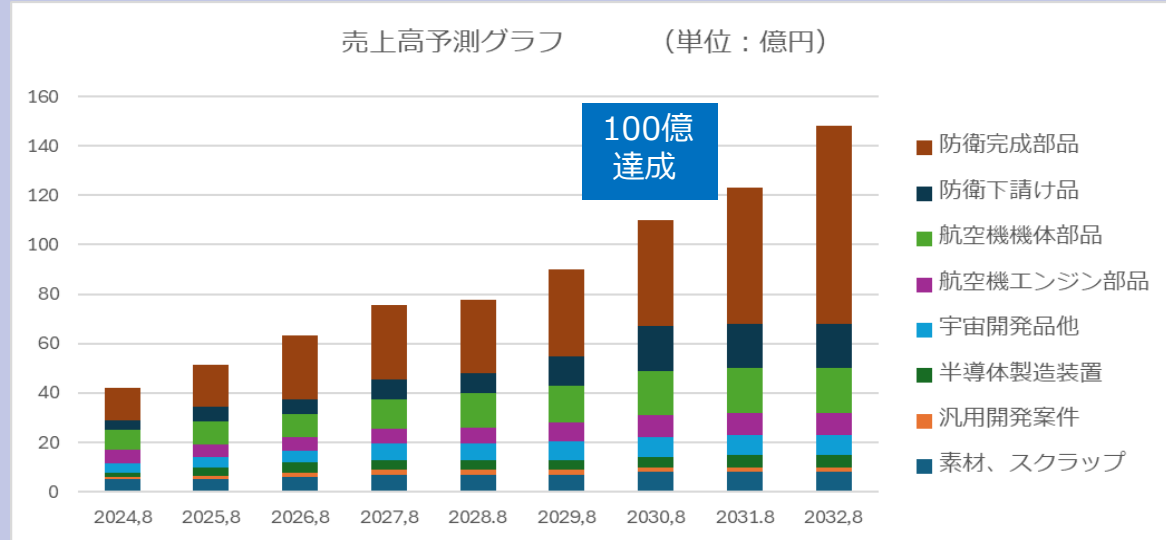
目指す成長手段

- ・全面的にデジタル活用を進め、過去の作業手順書を遠慮なく合理化してゆく。
- ・機齢の高い（20年前後）設備を改造や廃却、再配置し自動化無人化を進める。また、高度化された最新設備を複数導入、更新し生産能力倍増リソースを構築する。
- ・同時5軸加工機中心に高度化改造、複数工場に増設、再配置を行い社内製造能力が現有工場内で倍増できる投資を行う。

実施体制

- ・社内においては、余剰金を活用した自己資本増強（増資）や金融機関融資や補助金を積極的に活用し、社屋増築や新規大型設備導入、改造を積極的、かつ短期間で実行する。
- ・外部能力活用として中小企業診断士を交えた、総務や管理を中心としたシステム見直しや増強を行う。

当社の業種種類別の売上予測（計画）



2032年8月までの業種種類別の売上予測（計画）を示す。大きな売上増を計画している防衛完成部品においては、素材調達からプロセス全てを作業し組立前部品単体として顧客製品ブランドになるよう受注している。製造物責任、納期や品質を預かることで、ビジネス領域が広がり受注金額の増大につながる。また、その特殊な製造力への要請は国内防衛費増額によるものであり、中期的に継続する業務と考えている。

航空機機体、エンジン部品の多くはアメリカのボーイング社製品の2次的な下請け業務であり、日本作業分担もB787では35%である。コロナ禍で月産製造0となった経緯から、世界的に事業撤退や他事業展開する事業者もあり、2020年前の製造能力は半減状態とみている。航空機需要は回復しているが、製造力の不足を考えると当社作業量倍増は2年以内に対応しなければならない課題である。

半導体製造装置の部品においては、当社の出番は開発に寄り添いながらの量産変化対応力である。過去製造能力最大を維持しつつも、新しい要請は安定的にあるものと推察し売上規模を変更しない計画としている。

そのうえで、当社が100億円売上を目指せる環境なのは、コロナ禍での生産力削減もなく国内6か所（宇都宮、船橋、市川、駒ヶ根、松阪、長崎）に小規模でも特殊機械加工（同時5軸を多用した製造）を行える環境を持ち、継続的に毎年10億円程度の設備環境投資を継続してきたことで、増産対応力を顧客に示すことができた。引き続き、国内製造大手事業者からの要請は継続するものと考え、売上100億円を目指し維持する中堅企業を目指すこととしている。